

# 2024年3月期 第2四半期 決算説明資料

---

2023年11月17日



**内外テック株式会社**  
スタンダード3374

# 2024年3月期 第2四半期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

## 業績

- **前年同期比では減収減益**

⇒ メモリーの需給バランス調整局面による投資の先送りが影響。

- **通期については、期初予想（5月12日公表）を据え置き**

⇒ 上期は期初予想を上回ったものの、下期の回復時期が遅れる見通しから、通期業績予想は据え置く。

## トピックス

- **開発力強化のため開発投資を継続**

⇒ 江刺開発センター開設 2023年4月稼働

厚木開発センター開設 2023年8月稼働

⇒ 半導体市場の需要拡大への生産対応、及び顧客からのより高機能・高性能の要求が高まる真空／制御技術に対応する開発力を強化。

## 期初予想を上回ったものの、前年同期比では減収減益に

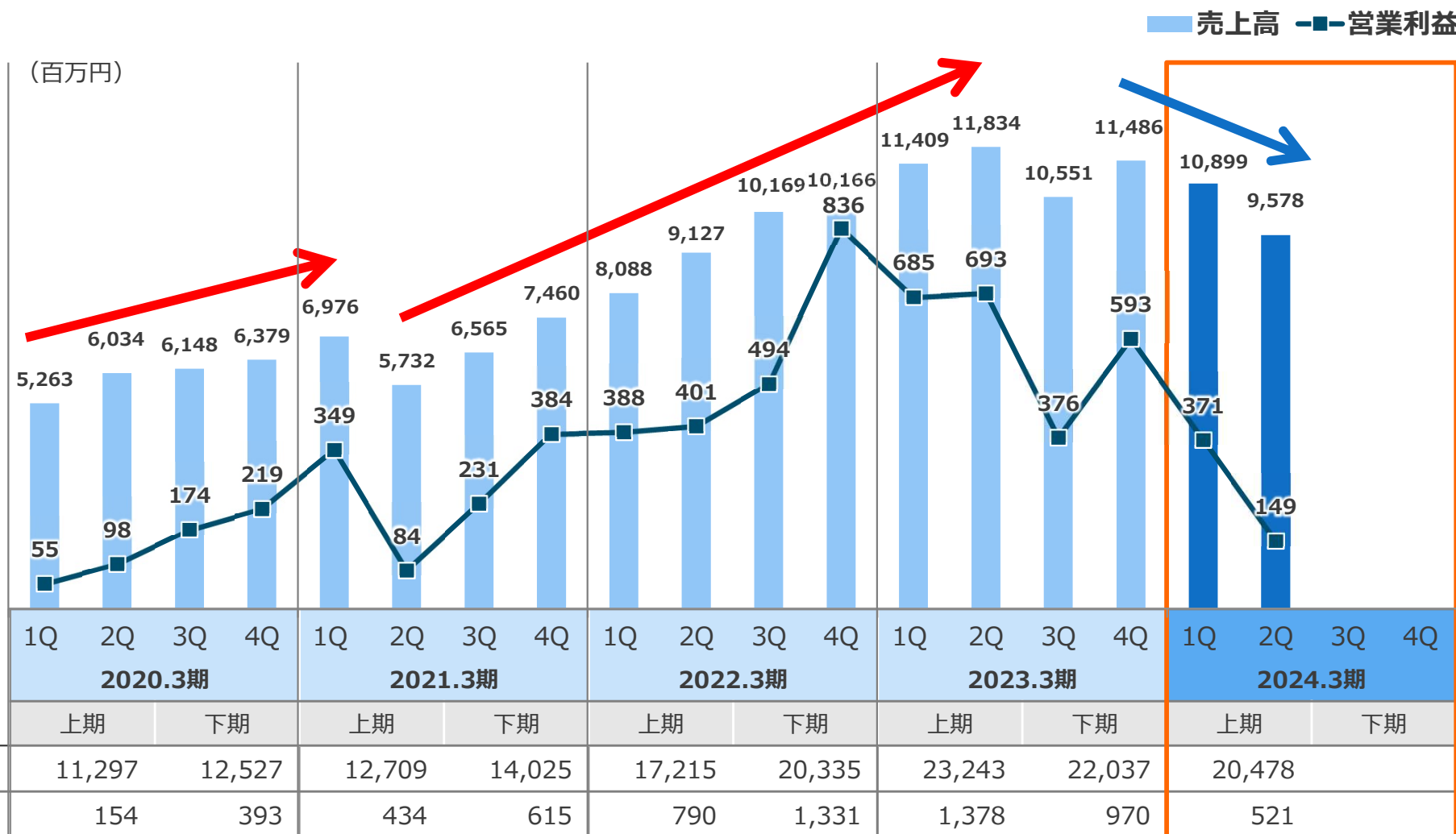
(百万円、%)

	2023.3期 上期			2024.3期 上期			期初予想
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	
売上高	23,243	35.0	100.0	<b>20,478</b>	△11.9	100.0	18,700
売上原価	20,477	34.1	88.1	<b>18,510</b>	△9.6	90.4	-
販管費	1,386	20.3	6.0	<b>1,446</b>	4.3	7.1	-
営業利益	1,378	74.4	5.9	<b>521</b>	△62.2	2.5	145
経常利益	1,374	75.9	5.9	<b>507</b>	△63.1	2.5	130
親会社株主に帰属する 四半期純利益	918	74.0	4.0	<b>324</b>	△64.7	1.6	62

- 売上高は、メモリーの需給バランス調整を背景に投資の先送りにより減収となるも、積極的な営業活動により期初予想は上回る。
- 減収に、商品仕入値や光熱費の高騰、前期の投資による減価償却費の増加等が加わり、売上原価率が上昇。
- 販管費は、将来を見据えた開発投資のため、研究開発費を中心に増加。

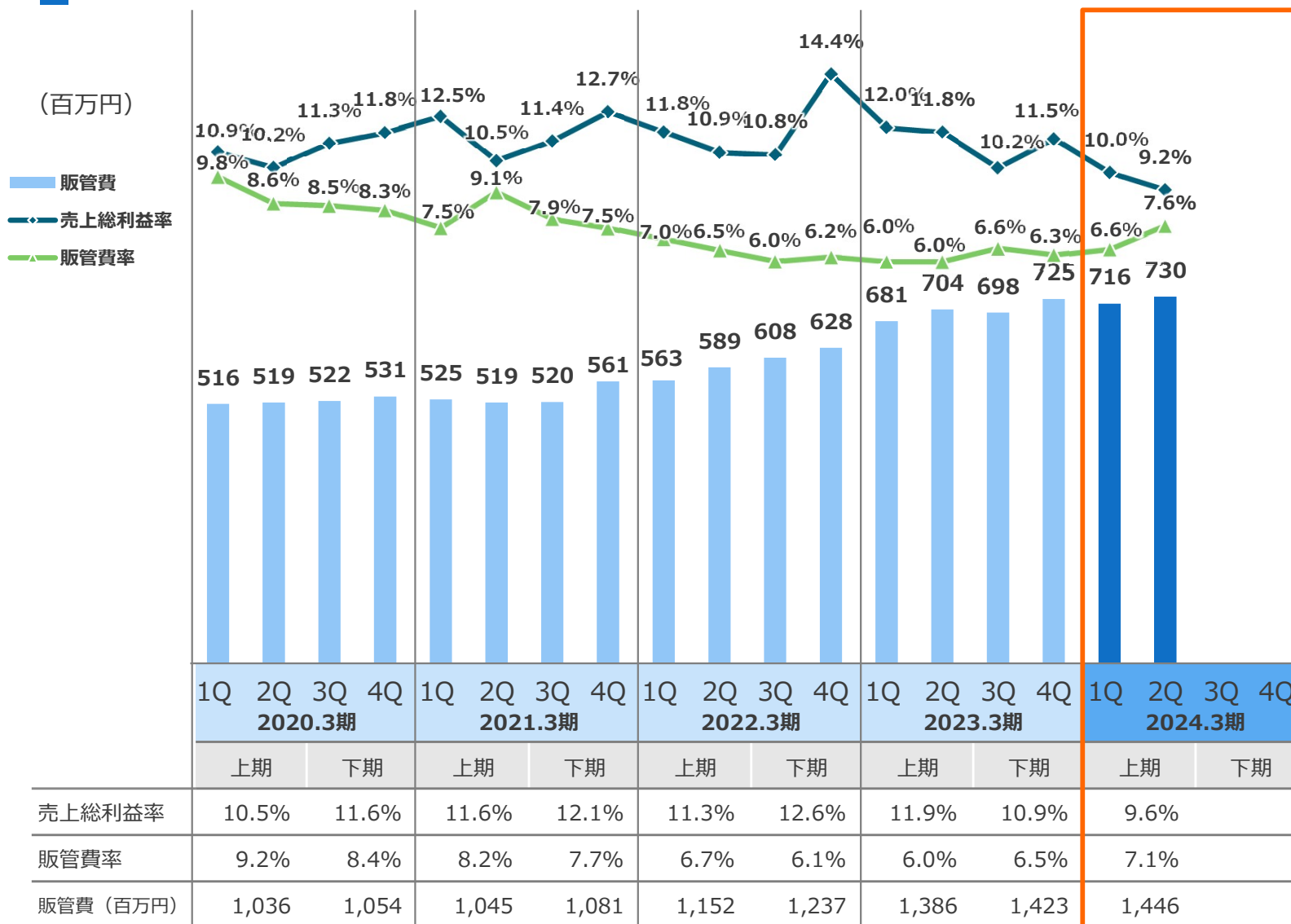
# 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

今期に入り、メモリーの需給バランス調整等から売上減少傾向  
営業利益も前年同期以下の水準に



# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、前期までの投資により固定費が増加し低下  
販管費率は、減収により上昇



## 売上総利益率

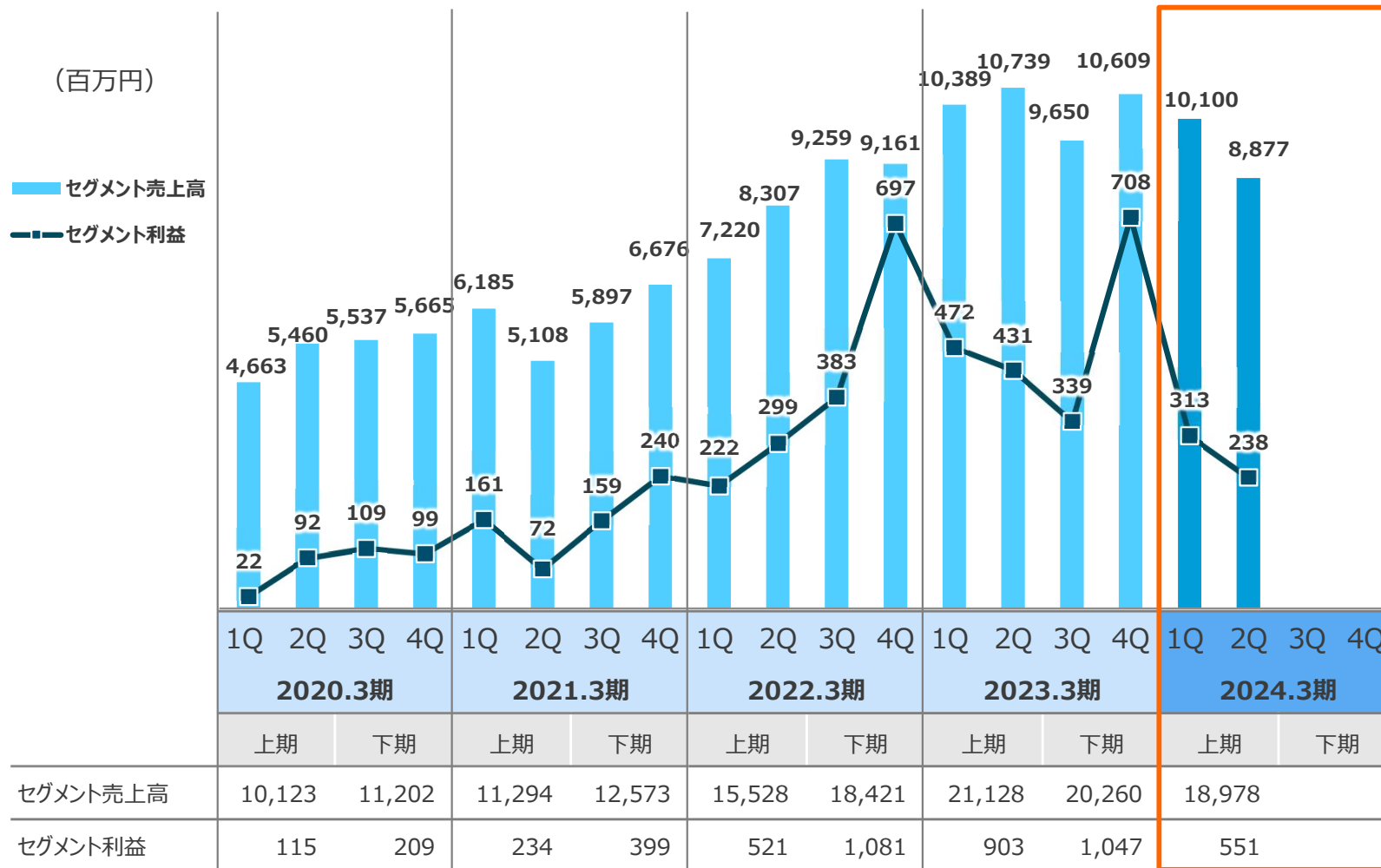
- 減収に加えて、前期までの投資や増員、及び電力費高騰の影響を受けて売上総利益率は低下。

## 販管費・販管費率

- 今後の成長戦略である開発力強化のため研究開発費用が増加し、販管費は増加。
- 販管費の増加に加え、減収により販管費率は上昇。

## 期初からの売上高減少で利益も急減

(百万円)



**セグメント売上高 18,978百万円**  
(前年同期比 ▲10.2% ↘)

- 前下期から続くメモリーの需給バランス調整等による投資の先送りから減収。

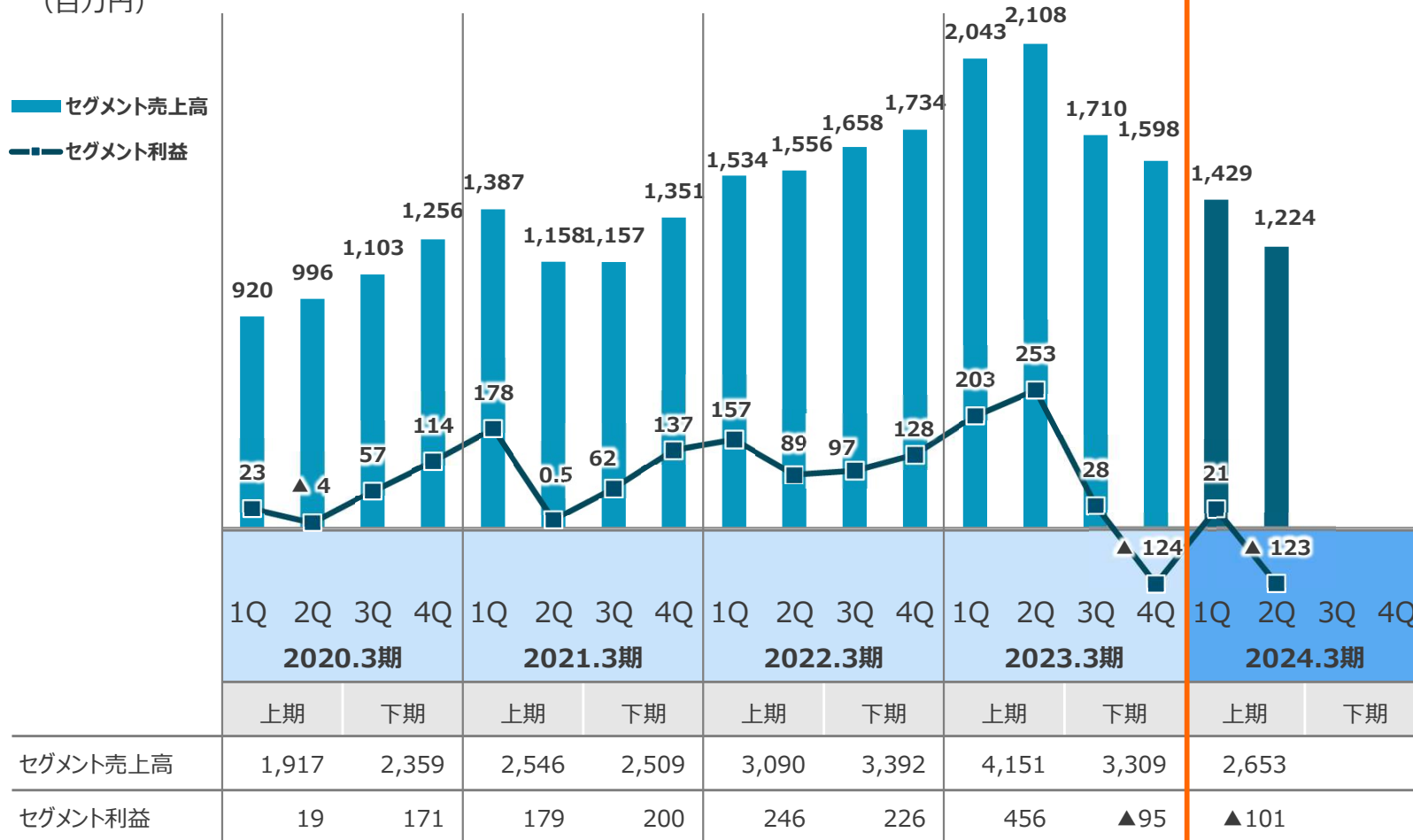
**セグメント利益 551百万円**  
(前年同期比 ▲39.0% ↘)

- 売上減少に加え、研究開発費用(161百万円)が増加し減益。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

## 前3Q以降、売上・利益ともに急低下 前下期に続き、セグメント利益は赤字に

(百万円)



**セグメント売上高 2,653百万円**  
(前年同期比 ▲36.1% 📉)

- 前下期から続く調整局面により半導体主要メーカーの投資先送りを受けて、主要顧客からの受注減少が継続。

**セグメント利益 ▲101百万円**  
(前年同期比 — 📉)

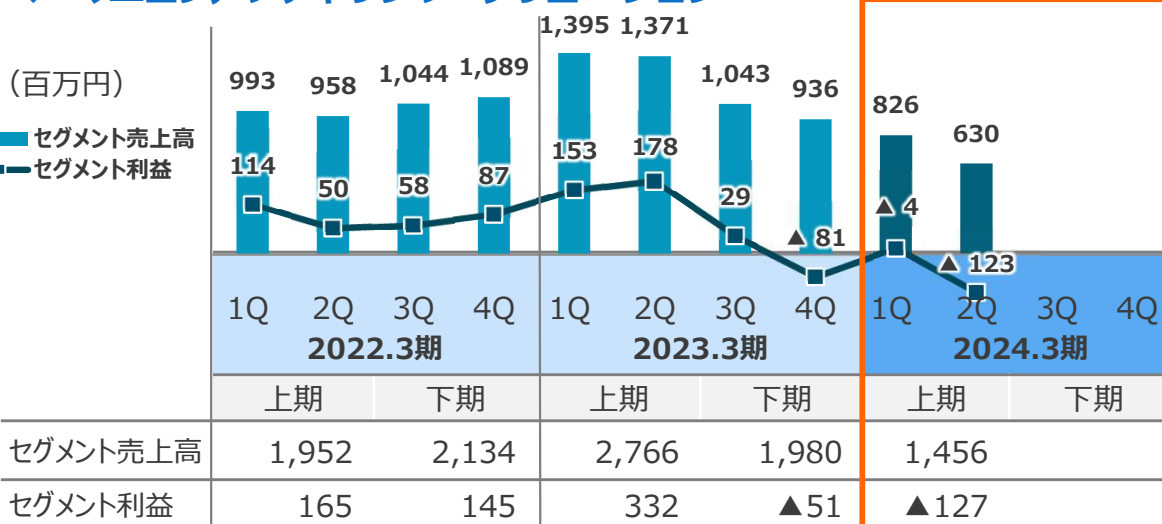
- 売上減少に加え労務費等の固定費が利益の押し下げ要因に。
- 2Qは一時的な要因による売上低下があるも、雇用維持により赤字に。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。



# セグメント情報：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニュファクチャリング・ソリューション



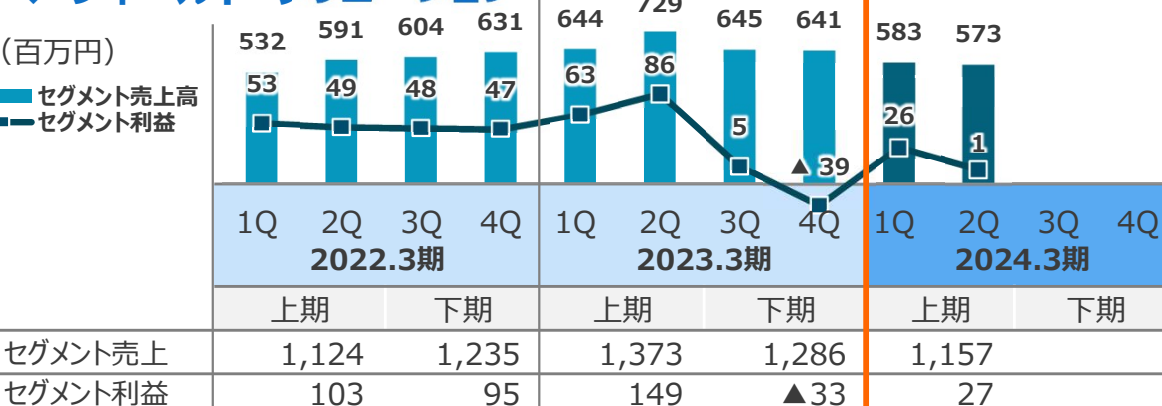
### 【事業内容】

顧客からの受託組立

### 【当期の概況】

- 半導体主要メーカーの投資の減少を受けて、主要顧客の減産による受注減少。
- 受注減少に伴い変動費の見直しを図るも、雇用維持したことから操業度の低下や光熱費高騰等により減益に。

## ◆ フィールド・ソリューション



### 【事業内容】

保守・メンテナンスサービス

### 【当期の概況】

- 半導体主要メーカーの投資抑制を受けて、装置立上受注が減少し減収。
- 今後の新規顧客獲得や受注拡大に向けた人員確保や教育等の先行費用が利益の押し下げ要因に。

## ◆ テクニカル・ソリューション

(百万円)

		2022.3期				2023.3期				2024.3期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
四半期ベース	売上高	7	5	9	12	3	7	21	20	19	20		
	利益	▲11	▲11	▲9	▲5	▲14	▲10	▲6	▲3	0	▲1		
半期	売上高	13		22		10		42		40			
	利益	▲22		▲14		▲25		▲10		▲1			

### 【事業内容と目的】

自社製品開発・技術開発

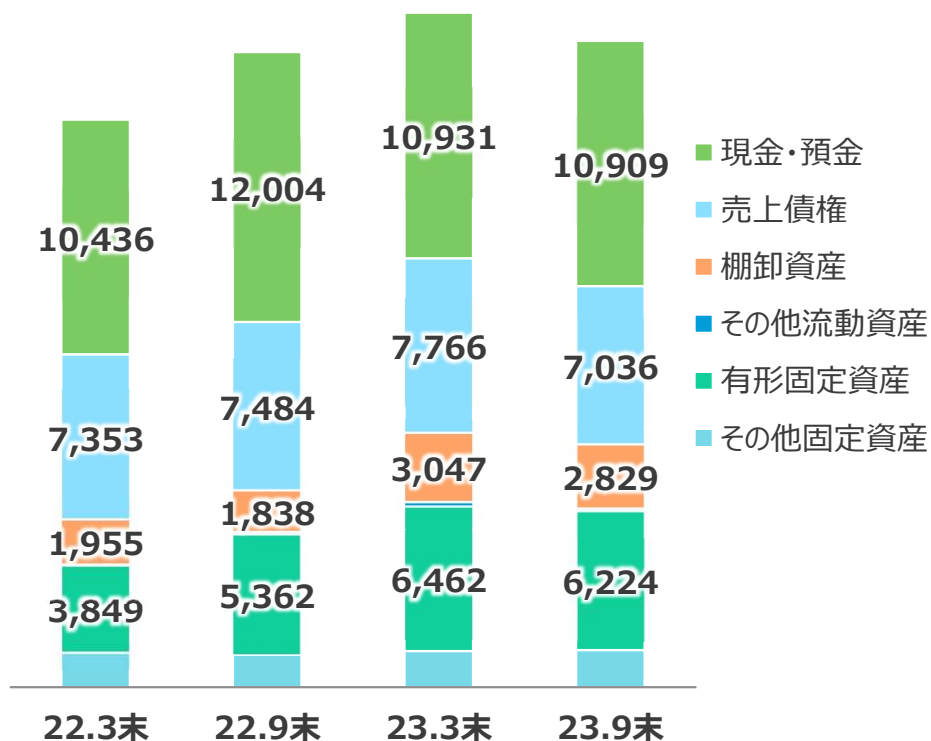
### 【当期の概況】

- 技術者の採用や技術研修等、製品開発に必要な技術の習得への投資を継続中。中長期的な成長戦略の中核へ。

# 貸借対照表

## ◆ 資産

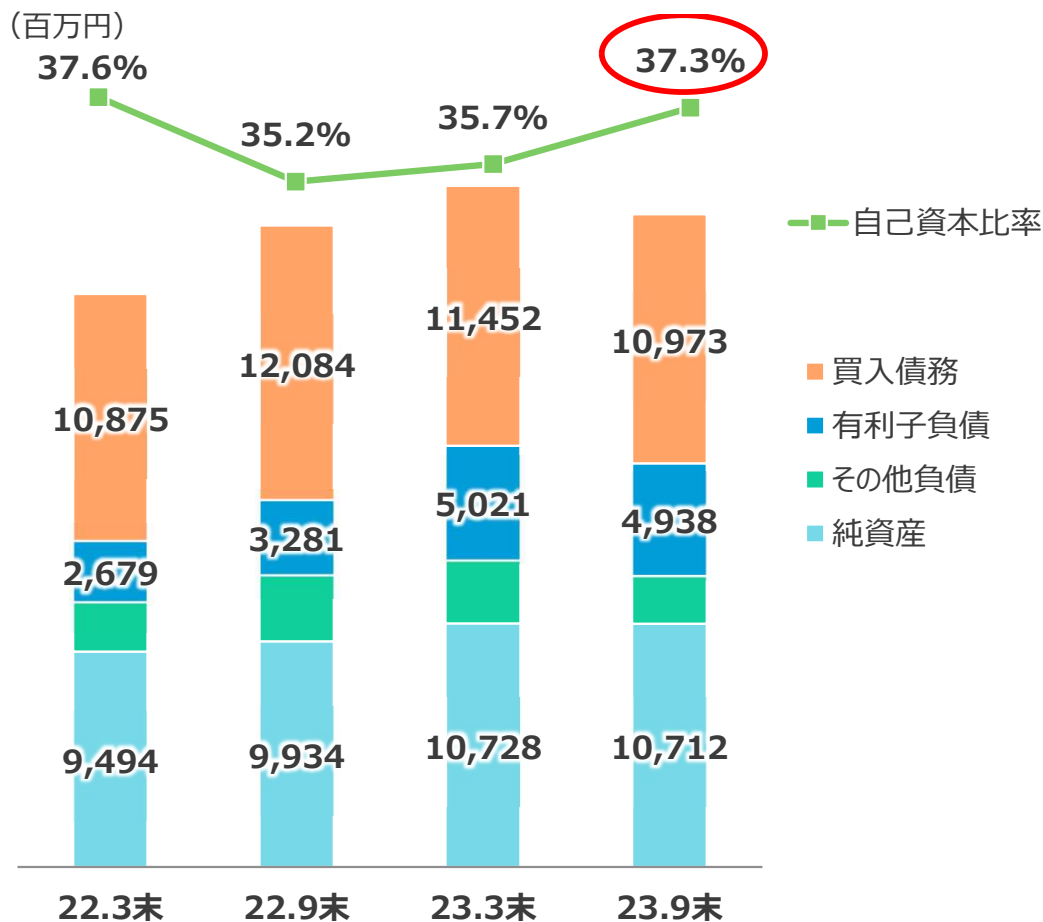
(百万円)



- 売上減少により、売上債権は7億29百万円減少。
- 一部を除きサプライチェーンの正常化が進み在庫抑制したことで、棚卸資産は2億18百万円減少。
- 大阪営業所の移転・売却により、有形固定資産は2億37百万円減少。

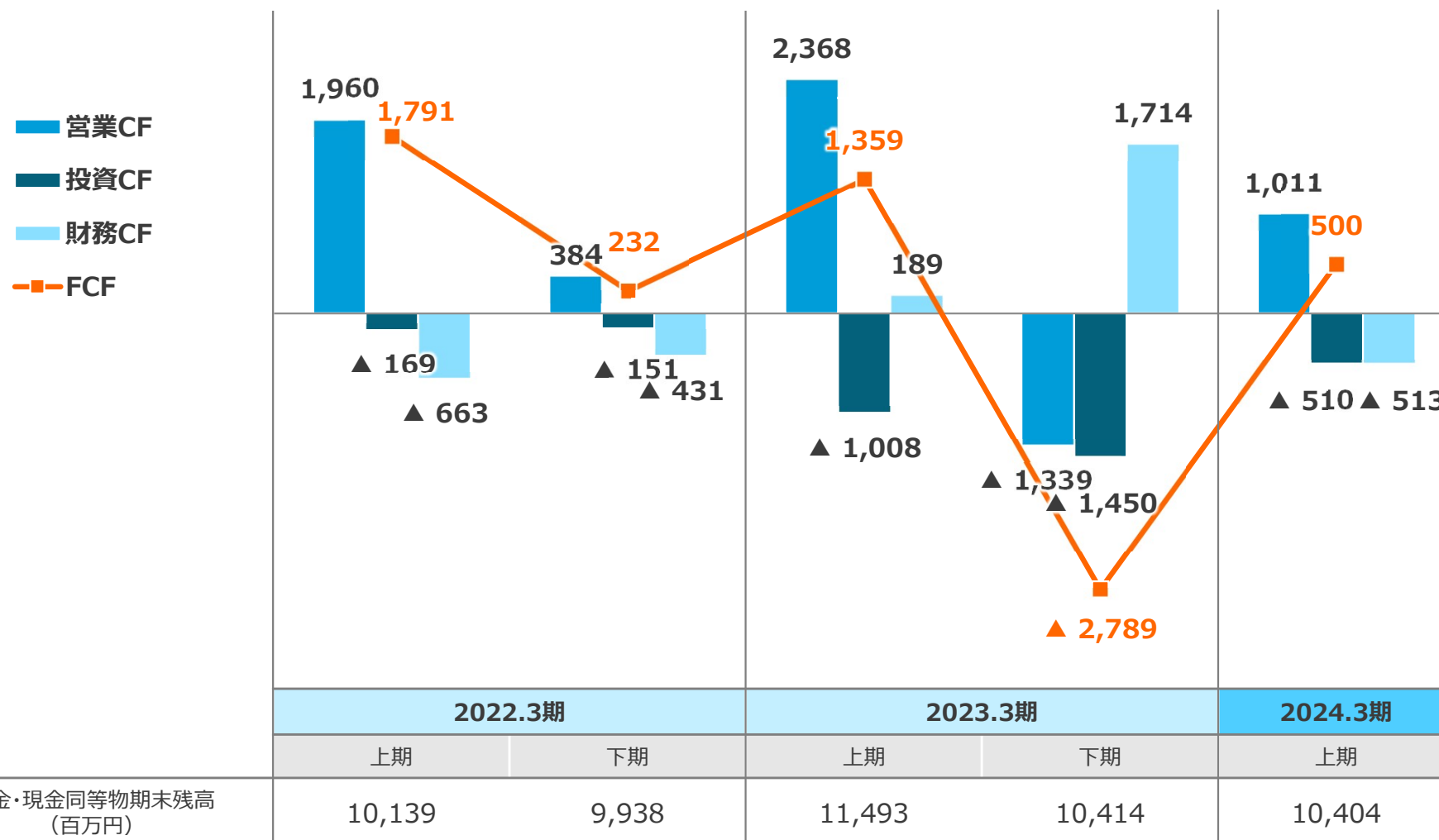
## ◆ 負債・純資産

(百万円)



- 売上減少により、買入債務が4億79百万円減少。
- 有利子負債は、江刺事業所建設に係る設備投資の借入等があるも、約定弁済により67百万円減少。
- 純資産は、利益の積み上げがあるも配当支払により微減。総資産の減少から、自己資本比率は上昇。

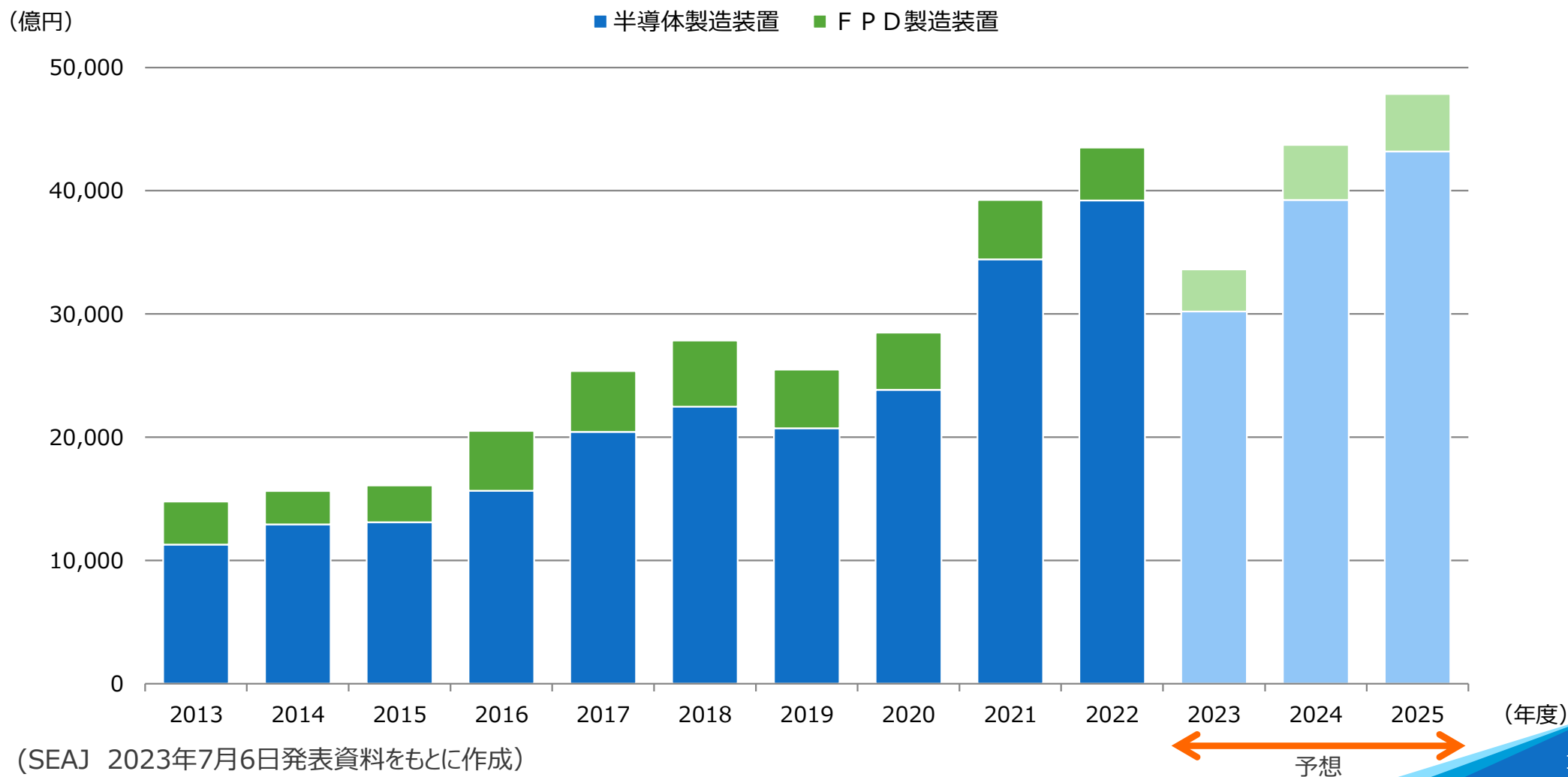
営業キャッシュフローは利益減で前年同期比で減少ながら、財務キャッシュフローと投資キャッシュフローのマイナスをカバーし、現金及び現金同等物残高は前期末と同レベルの104億円を維持



# 2024年3月期 連結業績予想

## 半導体製造装置を取り巻く環境は一時的な減速はあるが、 中期的には拡大傾向

### 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



# 2024年3月期 業績予想 ⇒ 変更なし

上期は期初予想を上回ったものの、下期の回復時期が遅れる見通しから、  
通期業績予想は据え置き

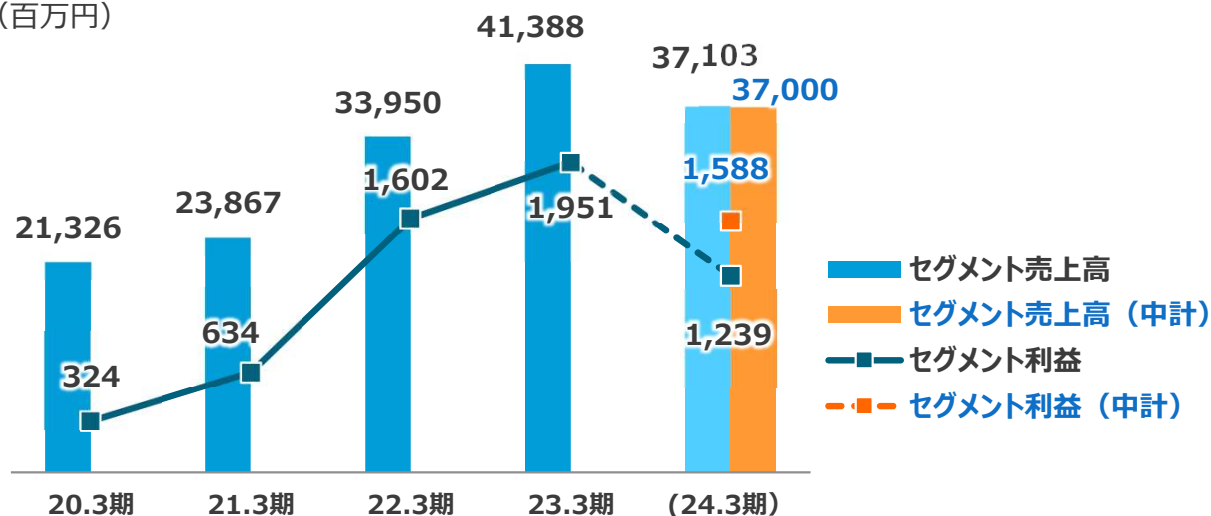
(百万円、%)

	2023.3期			2024.3期						
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	上期	上期進捗率 (対予想)	中計	中計比
売上高	45,281	20.6	100.0	40,100	△11.4	100.0	20,478	51.1	41,500	△3.4
営業利益	2,349	10.7	5.2	1,290	△45.1	3.2	521	40.4	2,655	△51.4
経常利益	2,336	10.8	5.2	1,260	△46.1	3.1	507	40.3	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,638	6.3	3.6	840	△48.7	2.1	324	38.6	—	—

# セグメント予想 ⇒ 変更なし

## ◆ 販売事業

(百万円)



### セグメント売上高

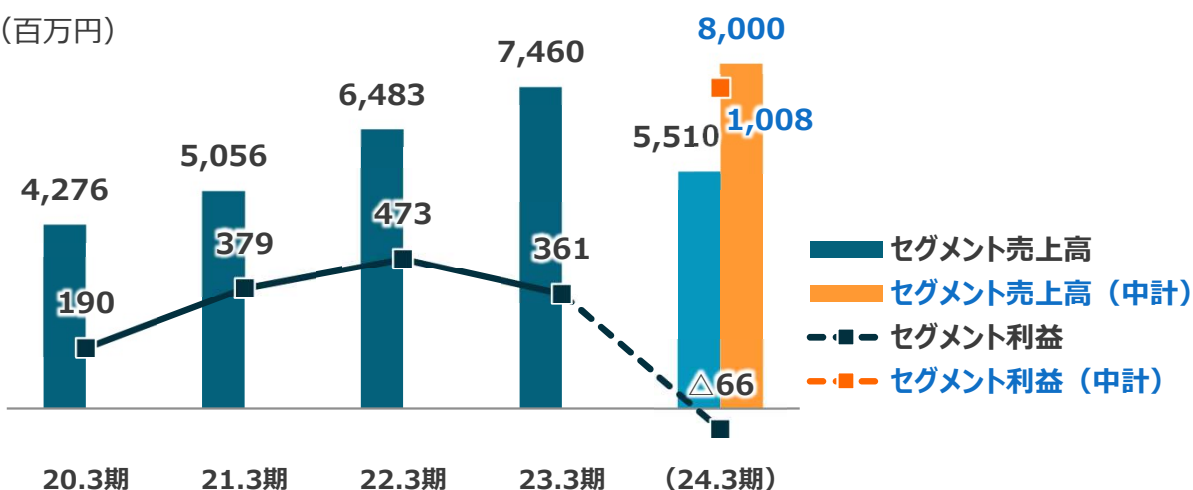
- 一時的な半導体需要減少を受けて設備投資の先送りを背景に回復時期の遅れのため、予想は据え置き。

### セグメント利益

- 回復時期の遅れから利益の急回復は困難なるも、期末の販売報奨金を含め収益の回復を見込む。

## ◆ 受託製造事業

(百万円)



### セグメント売上高

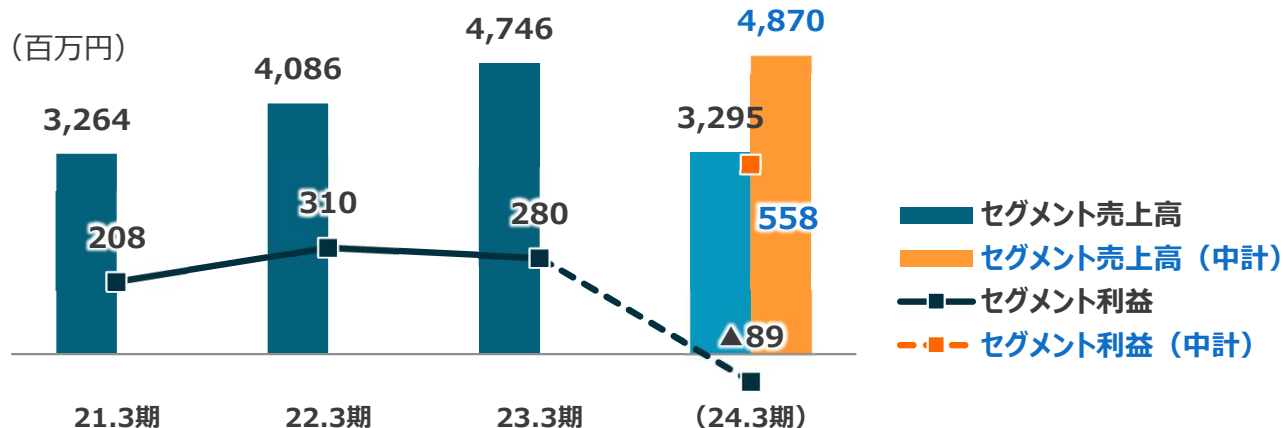
- 半導体メーカーの減産等による受注低迷はあるも、営業強化や新規取引獲得による回復を見込む。

### セグメント利益

- 設備投資による固定費の増加はあるも、新規取引の獲得や作業効率の改善で収益の回復を見込む。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション



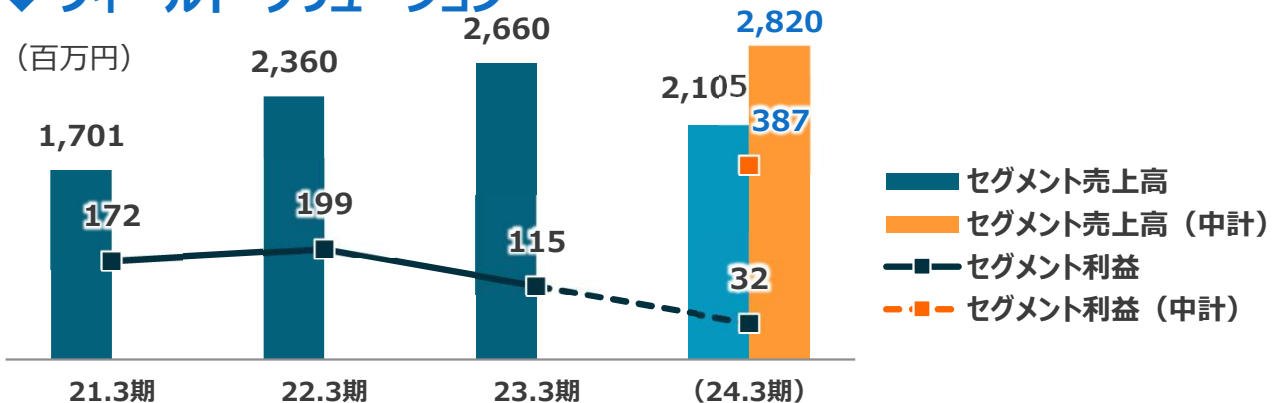
### セグメント売上高

- 半導体市場の調整局面を背景に設備投資の先送りにより、顧客からの受注減少により減収予想。

### セグメント利益

- 売上減少に伴い原価低減を図るも、操業度の低下により減益予想。

## ◆ フィールド・ソリューション



### セグメント売上高

- 半導体市場の調整局面を背景に、半導体メーカーの減産による保守・メンテナンスの減少や新規設備投資の先送り等による立上作業の減少により減収予想。

### セグメント利益

- 売上減少のため変動費の低減を図るも、新規顧客獲得に向けた人員確保や教育等の先行費用の増加により減益予想。

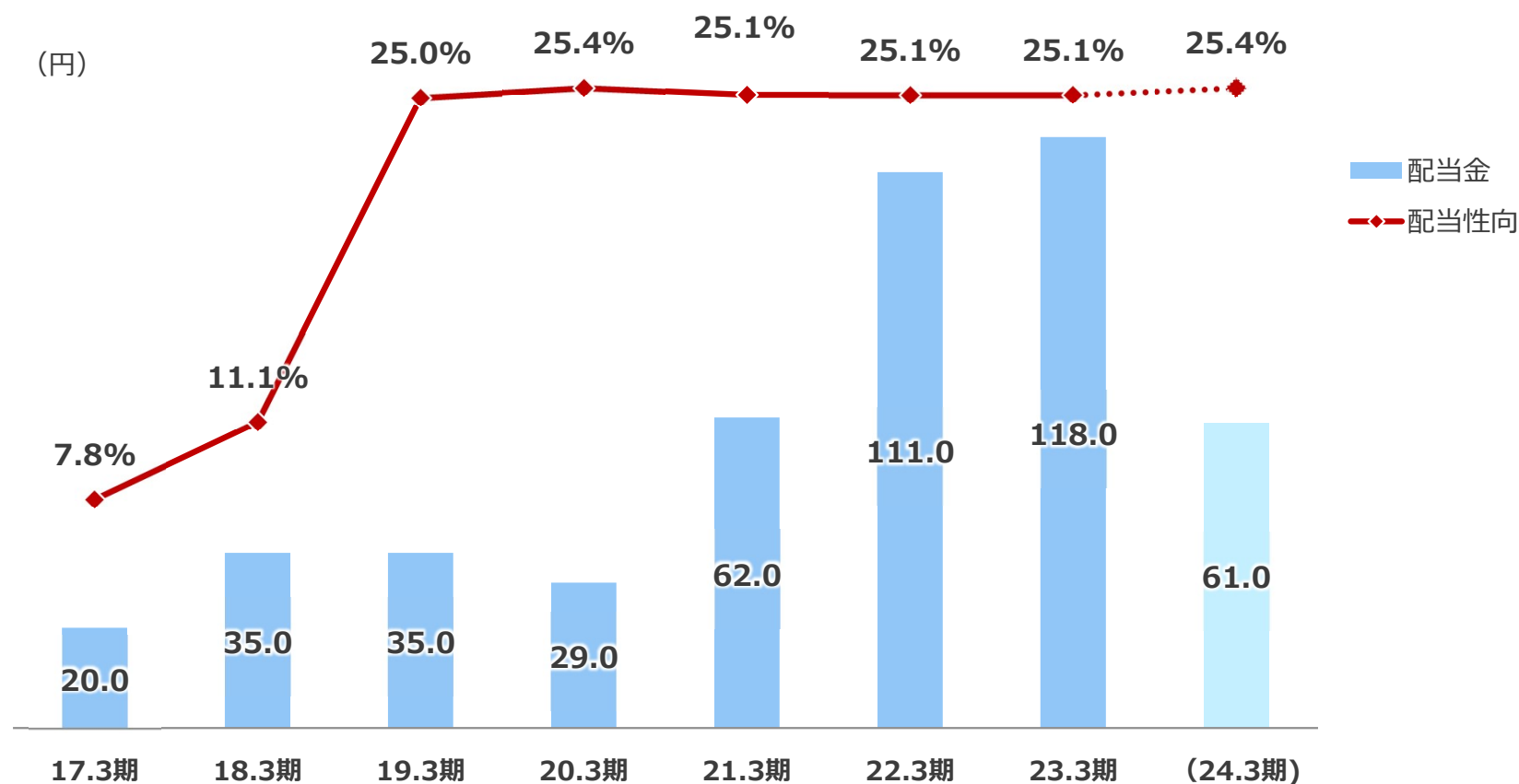
## ◆ テクニカル・ソリューション

	21.3期	22.3期	23.3期	(24.3期)	
	実績	実績	実績	計画	中計
セグメント売上高	90	36	52	111	310
セグメント利益	▲1	▲36	▲35	▲8	62

- 今後の成長を見据えた製品の受注と製造技術やスキルの向上に注力。



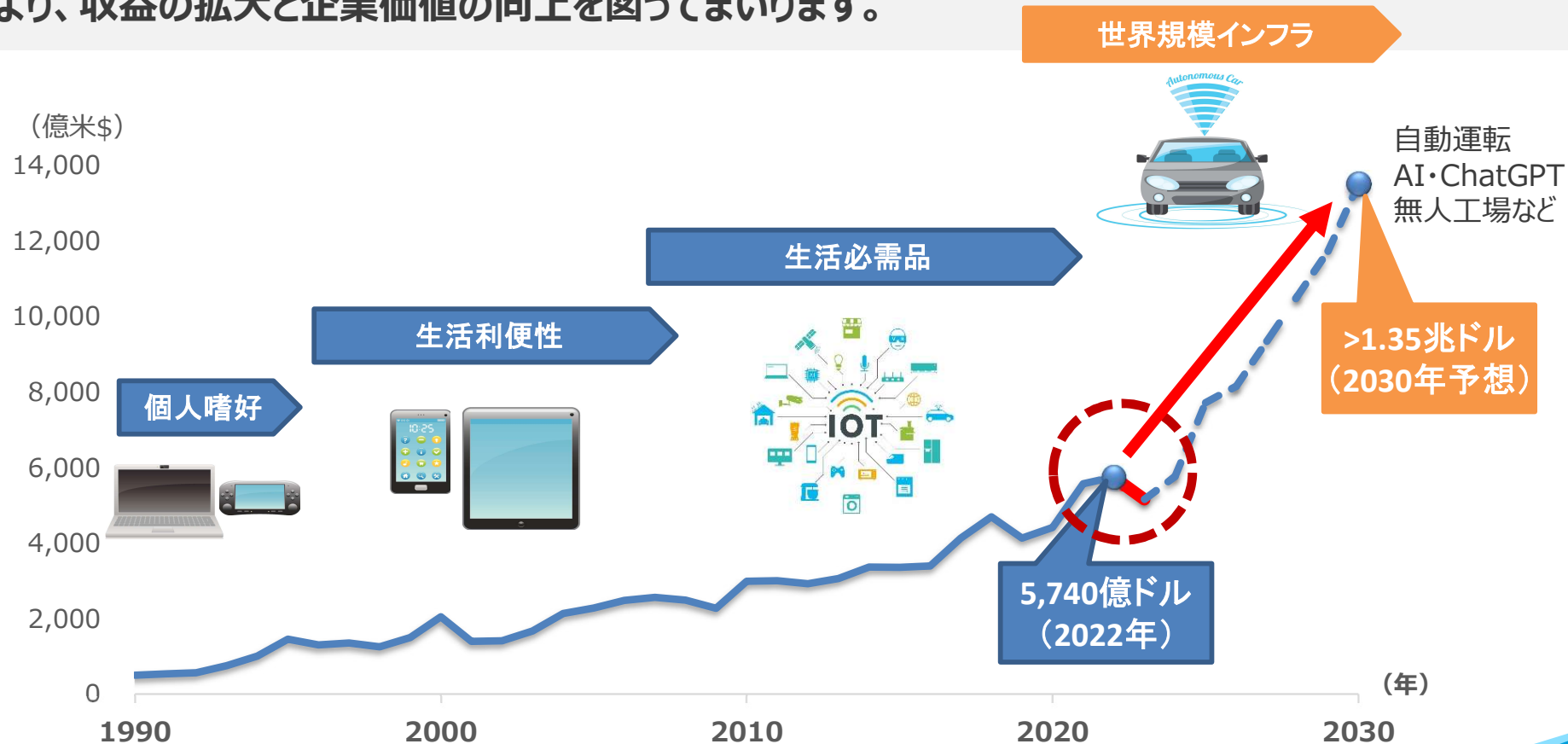
## 連結配当性向25%程度を基準



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

## 半導体需要は中長期的に急拡大 市場は、2025年には過去ピークを超えるものと予想

足元の半導体市場は一時的な低迷状況ですが、今後、半導体需要は急激に拡大すると確信しています。当社グループは、半導体の次の急回復に備え、投資を継続してまいります。半導体市場は変化が激しく、一時的な収益の悪化はありますが、市場拡大に伴い、これまでの投資・これからの投資により、収益の拡大と企業価値の向上を図ってまいります。



(世界半導体市場統計(WSTS)、International Business Strategiesの資料をもとに当社にて作成)

# **(参考資料)**

## **会社概要**

# 会社概要

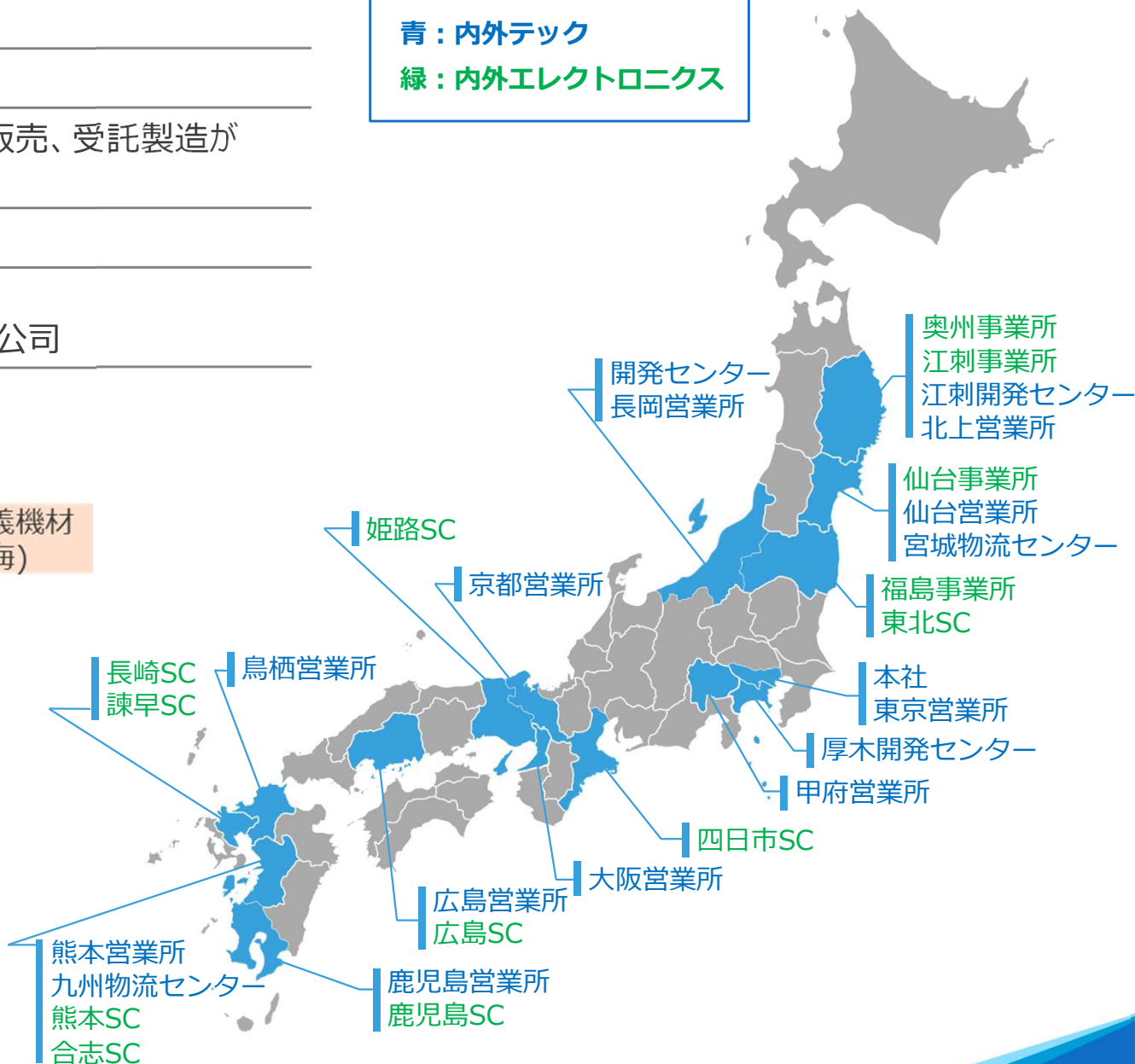
所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 656名 (2023年9月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

青：内外テック  
緑：内外エレクトロニクス

中国・上海



納宜伽機材 (上海)



## 半導体製造工程概要



中長期的に、生成AIを始めDX・GXや量子コンピューターの需要拡大を背景とした半導体市場の成長から、前工程の設備投資の拡大が見込まれる。

内外テック  
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー

＝ モノづくりができるメーカー商社

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社